

苏州锓威特半导体股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

苏州锓威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）为落实党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》指导方针，积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，切实履行上市公司责任担当，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》并扎实落地各项举措，经营质效、治理水平持续提升。结合行业趋势、公司战略及 2025 年实际经营情况，现将 2025 年年度行动方案执行情况及 2026 年年度行动方案报告如下：

一、聚焦主营提质，增强核心竞争力

公司始终坚守功率半导体领域发展定位，深化“功率器件+功率 IC”双轮驱动战略，以“管理赋能、执行保质、质量控本、协同增效”为经营方针，聚焦 BLDC 电机驱动、工业及车用电源、新能源及智能电网、高可靠用电源及电机驱动四大核心应用场景，以应用牵引技术迭代、以技术支撑市场拓展，系统性打造一体化芯片解决方案，推动公司经营业绩持续改善、盈利结构不断优化。

（一）深化技术研发，完善产品矩阵

电源管理 IC 方面，公司持续完善产品布局。隔离拓扑领域，已完成反激、正激、移相全桥等主要拓扑的系列化；其中移相全桥控制 IC 通过 AEC-Q100 车规认证，已获部分终端客户验证。针对工业电源，公司开展研发集成 SiC MOSFET 的专用电源管理 IC 及小型化隔离电源专用芯片，广泛应用于数字隔离器、隔离接口电路、隔离驱动的供电。非隔离领域，公司推出耐压 100V 以上的同步 Buck/Boost 控制器，并展开 1-8A 同步 Buck 转换器及 SiP 封装电源模块的研发，首颗电源模块产品已推出。此外，为提高电源系统的转换功率及可靠性，公司相继推出理想二极管控制 IC、浪涌抑制控制 IC 和高边开关控制 IC 三个产品子系列：理想二极管 IC 耐压达 $\pm 150\text{V}$ ，为当前国内外同类产品最高等级，适用于 72V/96V 电池系统；浪涌抑制 IC 已逐步进入量产阶段；高边开关控制 IC 推出

100V 智能高边开关控制器，具备完善的保护功能以及预充电功能。同时，公司正结合器件与 IC 优势，研发 100V/150V 理想二极管模块。

电机驱动 IC 方面，公司推出针对电动工具的 65V 三相半桥驱动 IC，以及面向工业伺服与慢速车的 250V 三相半桥驱动 IC，并同时展开 SiC MOSFET 专用驱动 IC 的研发。基于功率器件与驱动 IC 的协同优势，公司推出电机驱动用 IPM 模块系列，包括 500V~600V 集成 2A~6A FRMOS 的 IPM 模块、650V 集成 10A SiC MOS 的 IPM 模块、100V 集成 10A SGT MOS 的 IPM 模块。

在功率 MOSFET 方面：公司开发完善了沟槽 MOSFET 及 SGT MOSFET 的工艺平台优化和产品布局，开发了 40V、60V、80V、100V、120V SGT 工艺平台并完成了 12 寸晶圆产线的工艺开发。

SiC MOSFET 方面：公司加大 SiC MOSFET 加工的产能布局及工艺平台的开发，与国内晶圆代工厂合作开发了 750V、900V、1200V、1700V、2600V、3300V SiC MOSFET 的生产工艺平台，并进行了优化与升级，其中 1200V SiC MOSFET 工艺平台已成功进入中试阶段，新推出 2600V 和 3300V SiC MOSFET 产品，目前产品进入小批验证阶段。

在知识产权方面，公司本期新获授权发明专利 22 项，集成电路布图设计专有权 18 项；截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计共已获授权专利 149 项(其中发明专利 103 项、实用新型专利 46 项)，集成电路布图设计专有权 130 项。

(二) 精准拓宽市场，优化客户结构

1、**聚焦核心赛道市场拓展：**围绕四大核心应用场景，深入推进客户结构优化与市场纵深布局，深耕高可靠领域，强化重点客户配套能力；积极拓展工业控制、消费电子市场，重点推动光伏、储能等新能源高增长赛道产品规模提升，带动整体销售额稳步增长。

2、**加速产品落地与市场渗透：**推动已量产产品的市场深度渗透，加快在研与验证阶段产品的商业化落地，进一步提升在高可靠、工业控制等领域的市场份额与品牌影响力；依托“功率器件+功率 IC”协同优势，为客户提供整套芯片解决方案，助力客户降本增效，增强客户粘性。

3、强化营销协同与服务能力：推动销售部门与研发、运营等部门高效协同，快速响应客户差异化需求；利用募投项目打造的测试及可靠性考核平台，提升技术服务质量与时效性；建立专业市场调研队伍，深入了解客户未来需求，精准把握市场机遇，争取更多项目合作机会。

（三）优化运营管理，强化质量管控

1、完善全生命周期质量管理体系：将质量要求贯穿设计开发、供应链协同、生产制造、交付服务全业务环节，系统开展质量改进专项行动，攻克产品可靠性技术难题，推动高难度产品良率稳步提升；深化供应商质量管理，建立现场审核、联合改进与责任闭环机制，从源头保障来料与外协环节的一致性和稳定性；增强检验检测能力，广泛应用自动化检测手段，拓展可靠性验证与认证资源，支撑车规级及高可靠领域产品研发与交付。

2、打造高效运营保障体系：构建“纵向贯通、横向协同”的运营体系，打破部门壁垒，围绕四大核心产品线进行深度重组与横向布局，强化产品线全生命周期管理，深化研发与市场联动机制，推动公司从单一芯片供应商向整套芯片解决方案提供商转型；建立重点产品保供机制与专项项目管理团队，统筹生产资源，保障产品交付；推进供应链资源整合，开发关键 FAB 及封测供应商，丰富供应链储备并实现成本优化；优化 ERP 系统逻辑，实现从需求提交到生产交付的全流程可视化管控，提升仓储物流效率，优化库存结构。

3、强化资金与资产运营管理：持续加强应收账款管理，完善回款管控机制，保障回款质量；针对库存制定精细化管理方案，加速超期库存消化，提升资产周转效率与资金使用效率，实现降本增效。

2026 年，公司将继续秉持“功率器件+功率 IC”双轮驱动战略，以技术创新为引擎，加速高附加值产品的商业化进程与市场渗透，进一步深化研发与市场的联动机制，把握国产化替代进程的关键机遇，持续优化客户结构与供应链布局，强化全生命周期质量管理与运营效能，致力于实现经营业绩的稳健恢复与核心竞争力的全面提升，为股东创造长期价值。

二、持续优化公司治理，提升规范运作水平

公司以合规经营为底线，持续完善法人治理结构，深化合规体系建设，强化

“关键少数”履职能力，推动治理机制与公司发展战略相适配，切实保障股东合法权益，为公司高质量发展提供坚实治理保障。

（一）完善法人治理结构，保障治理机制高效运行

报告期内，公司顺利完成董事会及其专门委员会、高级管理人员的换届工作，充分发挥董事会、审计委员会等治理机构的职能作用，保障职工董事参与公司治理的权利，实现监督职能平稳有效运行；结合监管政策更新及公司发展实际，持续修订《募集资金管理制度》《内部问责制度》等内控制度，夯实合规经营基础。

（二）深化合规体系建设，加强内控风险管控

报告期内，公司将合规管控嵌入业务流程各环节；在 ERP 等核心系统建设中前置合规控制节点，强化资金运作、投资决策、信息披露、信息安全等高风险领域的全过程管理；持续完善内控相关流程优化及信息化建设，不定期开展业务流程合规排查，及时纠正不规范操作；深化内控风险评估机制，密切关注外部政策环境与内部经营状况变化，动态调整风险应对措施，保障公司各项经济活动合法合规。

（三）“关键少数”履职强化，合规意识深化

报告期内，公司持续向董事、高级管理人员传递最新证券法律法规、监管政策及行业监管动态，针对会计监管案例、科创板信息披露直通车、并购重组专刊等方式，确保董事、高级管理人员准确把握监管要求；积极组织董事、高级管理人员参加上交所、地方证监局等机构的培训，加强证券市场法律法规和专业知识学习，不断提升风险意识、自律意识和履职能力；强化“关键少数”对公司战略规划、经营管理的把控能力，推动公司决策效率与合规水平双提升。

2026 年，公司将按新施行的《上市公司治理准则》推进公司治理，紧扣“强监管、防风险、促发展”主线，系统推进治理架构优化与规范运作水平提升。聚焦“关键少数”契约约束，强化全周期监管，建立健全约束及激励机制，夯实公司持续健康发展的治理根基。

三、深化投资者关系管理，优化互动机制

公司始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，以提升信息披露质量为核心，丰富投资者互动渠道，深化与投资者的沟通交流，减少信息不

对称，推动市场认知与公司内在价值相匹配，切实维护投资者关系，提升资本市场信心。

（一）提升信息披露质量，履行信息披露义务

报告期内，公司严格按照法律法规、监管要求及公司制度，及时、准确披露公司经营业绩、重大经营事项、研发进展、战略规划等重要信息，确保信息披露内容的真实性、完整性和公平性；优化信息披露流程，加强信息披露审核，提升信息披露的及时性与规范性，保障投资者的知情权。

（二）丰富投资者互动渠道，深化沟通交流

报告期内，公司持续畅通上证 e 互动平台、投资者电话、邮箱等常规沟通渠道，安排专人及时响应投资者咨询与问题，虚心接纳投资者关于公司生产经营、战略规划的合理化建议；保持业绩说明会常态化召开，围绕年度、半年度、季度经营业绩，向投资者详细说明公司财务状况、经营成果、研发进展、市场布局等情况，直面投资者关心的问题，进行深度交流；充分利用公司官网、微信公众号、行业展会等多渠道，及时传递公司技术突破、产品落地、市场进展等价值信息，全方位展示公司发展成果与核心价值。

2026 年，公司将持续夯实信息披露质量，以合规性与透明度为基石，确保披露内容的真实、准确、完整；进一步丰富投资者沟通场景，提升公司与资本市场沟通的深度与广度。公司将着力构建双向赋能的投资者关系管理体系，积极听取市场意见，传递公司战略逻辑与长期价值，推动市场认知与公司内在价值深度趋同，切实维护投资者权益，增强资本市场对公司的信任与认同。

四、稳步实施回购计划，切实维护股东利益

报告期内，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，维护广大投资者利益，公司首次实施回购股份，并于 2025 年 12 月 15 日实施完毕股份回购计划，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 605,400 股，占公司总股本的 0.82%，已支付的总金额为 19,994,304.08 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进实现企业价值与股东回报的双重提升，有效保障投资者权益。

公司于2026年4月8日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，鉴于2025年公司归属于母公司所有者的净利润为负数，结合公司经营发展实际、盈利状况、资金需求及行业发展特点，兼顾公司短期经营发展与长期战略布局，公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司将持续强化核心竞争力，推动经营效益稳步提升，实现公司盈利能力与经营规模的双增长，为股东回报奠定坚实的经营基础；公司将严格按照《公司章程》等相关规定，在符合利润分配条件的前提下，积极实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等利润分配方式，提升股东回报水平，切实回报全体投资者，实现公司与投资者共享发展成果。

五、其他相关说明

2025年，公司“提质增效重回报”行动方案各项举措落地见效：核心产品研发持续突破，市场拓展进入头部客户供应链；治理结构改革平稳落地，合规水平进一步提升；投资者沟通机制不断完善，回报机制稳步推进。2026年公司将本行动方案为指引，凝心聚力、真抓实干，持续推进“提质增效重回报”各项工作，不断提升公司核心竞争力与经营效益，完善公司治理与投资者回报机制，切实履行上市公司责任担当，以良好的经营业绩和规范的公司治理回报全体投资者的信任与支持，推动公司实现高质量、可持续发展。

本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，本方案所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司

董事会

2026年4月10日